

# 低粘度による高充填ソリューション

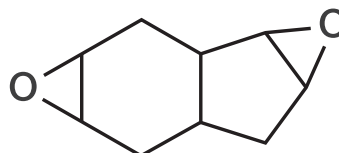
Increasing filler contents with Low viscosity

脂環式骨格で20mPa・s@25°Cの低粘度のTHI-DEの配合により、  
フィラーの高充填化が可能です

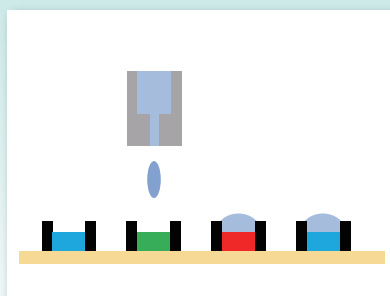
Increasing filler contents with Low viscosity (20mPa・s @ 25 °C) THI-DE

## ● 期待される効果 Effects ●

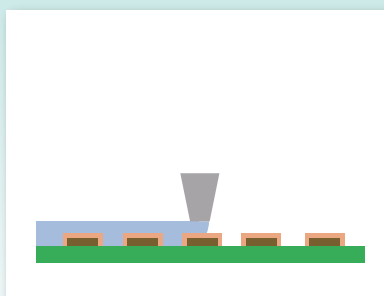
- ◎ 機能性の付与  
Adding functional substances
- ◎ 耐熱性向上  
Increasing heat resistance
- ◎ 他エポキシとの併用可  
Enable to mix with Other Epoxy materials



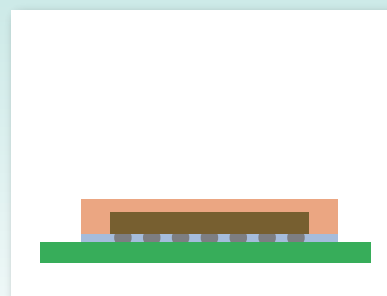
## ● 想定用途 Applications ●



インク基材 (インクジェット他)、  
封止材  
Ink Base, Encapsulator



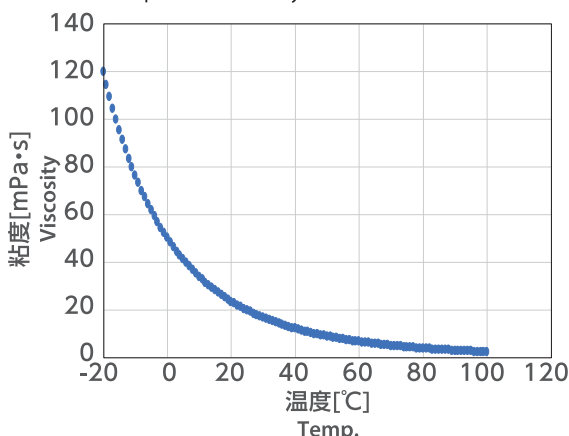
塗布膜  
Coatings



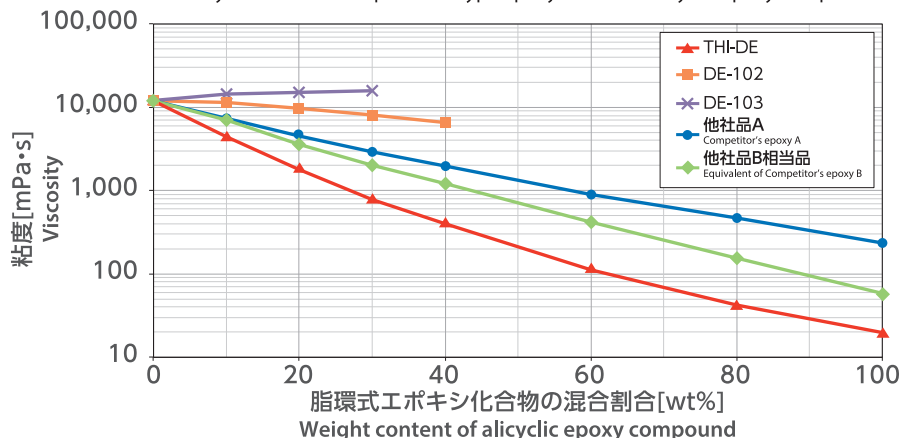
接着剤  
Adhesives

## ● EPOCHALIC™ THI-DEの粘度特性 Viscosity Properties of EPOCHALIC™ THI-DE ●

粘度の温度依存性  
Temperature / viscosity chart



ビスフェノールA型エポキシ樹脂混合時の粘度  
Viscosity of mixture of bisphenol A type epoxy resin and alicyclic epoxy compound



ENEOS株式会社